지식경제부 Ministry of Knowledge Economy **보도자료**	http//www.mke.go.kr
2010년 10월 30일(토) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.	
자료문의 : 반도체디스플레이과 문신학 과장(2110-5680) 김봉석 사무관, 양유리 주무관(2110-5682~3)	

반도체, 「대·중소기업 동반성장」으로 "반도체 KOREA, 제2의 도약" 다짐

- '반도체산업 동반성장 5대 핵심과제' 발표 -

(자금·R&D·구매·공정거래·인력)

- 10.29(금), 제3회 「반도체의 날」 행사 개최 -

□ 한국반도체산업협회(회장 : 권오현 삼성전자 사장)는 **10.29일 저녁 여의도 63빌딩**에서 **최경환 지식경제부장관**을 비롯한 산·학·연 관계자 **5백여명**을 초청하여 **「제3회 반도체의 날」** 행사를 가짐

○ 이날 기념행사에는 국회 지식경제위원회 **노영민 의원**(민주당) 등 **주요 인사들이 대거 참석**하여 반도체 산업인들을 격려함

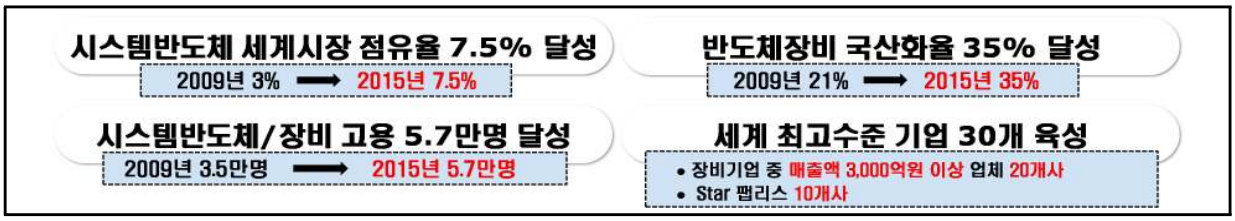
□ 금번 '반도체의 날' 행사는 그간 유례없던 세계 반도체 경기침체 속에서도 올해 우리 반도체산업이 **사상 최고의 세계 시장점유율**[1](50%)을 **기록**하면서, **다시 수출 1위**[2] **품목으로 재부상**했을 뿐만 아니라,

1) 메모리 시장점유율(%) : ('08) 42.7 → ('09) 46.1 → ('10.1Q) 47→ ('10.2Q) 49.6
2) 반도체 수출액(억불) : ('08) 328 → ('09) 310 → ('10^{E}) 516

○ 삼성전자와 하이닉스도 **사상 최대의 영업이익 실현이 예상**됨에 따라, 이를 기념하고 축하하는 반도체인의 축제의 장이 되었음

□ 특히, 금번 행사에서는 이러한 메모리부문 세계 1위를 기반으로 **시스템반도체·장비산업 육성**을 통해 **진정한 반도체강국으로 도약**키 위한 **「반도체산업 2015 비전」 선포**와, 이에 대한 실천방안을 천명하는 **「반도체산업 동반성장 협약식」**이 **거행**되었음

【 반도체산업 2015 비전 】



○ 이 자리에서 수요대기업(삼성전자, 하이닉스)은 자금·R&D·구매·공정거래·인력 부문에 걸친 **'동반성장 5대 핵심과제'**를 발표하고, **수요대기업의 성공신화가 중소협력사로** 이어질 것임을 선언함

【동반성장 5대 핵심과제】

① 반도체펀드 조성, 상생보증프로그램 운영 등 자금 지원
② 공동개발·공동구매 품목 및 성능평가 대상 분야 확대
③ 파운드리 개방 확대 및 스타 팹리스기업 육성
④ 대-중소기업간 공정한 거래 확립
⑤ 중소기업의 핵심역량 확보, 경영혁신 및 전문인력 지원

○ 이를 위해, 수요대기업(삼성전자, 하이닉스)-팹리스·장비·소재 중소협력사-정부간 긴밀한 협의를 통해 **세부 실행계획을 11월까지 마련**키로 하였음

□ 또한 금번 행사에서 정부는 **경제위기 극복 및 무역수지 개선**에 있어 **반도체 산업이 크게 기여**한 점을 감안, **위기 극복**의 주역들과 **반도체 산업발전과 기술개발에 공이 큰 유공자**에 대하여 **포상**을 행함

* 정부포상 총 28점 : 훈장(2), 포장(1), 대통령표창(2), 국무총리표창(3), 장관표창(20)

○ 국내 시스템 반도체 기술수준을 글로벌 수준으로 향상시킨 공로로 **삼성전자의 우남성 부사장**이 **은탑산업훈장,** 반도체 핵심재료의 국산화 기여로 **피케이엘의 정수홍 사장**이 **석탑산업훈장**의 영예를 차지함

○ **하이닉스 김동균 전무**가 **산업포장, 세메스**의 **남상권 사장**과 **서울대학교 김재정 교수**가 **대통령표창** 등 총 28명에게 정부 포상이 이루어짐

※ 수상자 명단 및 공적개요 별첨

□ 업계는 반도체산업발전을 위해 공헌해 준 **노영민 의원**과 **윤영각 삼정 KPMG 대표**에게 **감사패를 증정**하고, 미래에 반도체산업을 이끌어 나갈 **우수 인재 34명**을 선발하여 총 **3.4억원의 장학금******을 수여**함

* 노영민의원은 '국회 신성장산업포럼'대표로서 반도체 산업발전 기여, 윤영각 회장은 반도체기업의 국제회계기준 적용 및 컨설팅 지원 등 기여

** 총 31개 기업이 출연하여 대학(원)생 1인당 1천만원씩 지원

○ 아울러, 그간 **대·중소기업 동반성장** 일환으로 추진해 온 **국내 장비·재료 성능평가 사업*** 결과, 삼성전자, 하이닉스 등으로부터 **우수 제품으로 평가**된 **9개 품목**(7개 기업)에 대한 **인증서 수여식**도 함께 진행됨

* 반도체 대기업 3사(삼성전자, 하이닉스, 동부하이텍)가 중소 장비·재료 업체에서 개발한 제품을 양산라인에서 테스트, 성능을 검증해 주는 사업으로 '07.3월부터 총 5차례에 걸쳐 사업을 추진(장비재료 구매예상액(누적) : 총 4,500억원)

□ 한편, **최경환 장관**은 **축사**를 통해 우리 반도체업계가 지난 수 년간의 위기를 **과감한 R&D와 설비투자로 극복한 것을 높이 평가**하며, **한국반도체산업 위상을 높인 유공자들을 표창하고 격려**하였음

○ 또한, 우리 반도체산업이 **진정한 반도체강국으로 도약**하기 위해서는 메모리반도체보다 시장규모가 크고, 고용창출효과가 큰 **'시스템반도체와 장비·재료산업'의 육성이 시급함**을 언급하고,

○ **반도체산업**이야말로 **'대·중소기업간 동반성장'**이 **구현**될 수 있는 **가장 전형적인 산업**이며, 시스템반도체와 장비·재료산업에서 대·중소기업간의 파트너쉽이 잘 이루어질 수 있도록 당부함

□ **「반도체의 날」**은 **2008년 처음 제정**되어, 반도체 수출 100억불 돌파일('94.10.29)인 **10월 29일**에 개최되는 **반도체인들의 축제일**로서 올해 **세 번째 행사**로 개최되었음

별첨1 제3회 「반도체의 날」 행사 개요

1. 「반도체의 날」 개요

○ 반도체산업은 **국가 핵심수출산업**이며 **他산업의 기반 주력산업**으로서 국가경제발전 주도, '08년 **"반도체의 날"*** 최초 지정

* '94년 반도체수출 100억불 달성 기념일인 10.29일로 지정

○ 금년에는 **경제위기를 극복**하고, 세계 최고 경쟁력을 갖추는데 크게 기여한 데 대한 업계관계자 **포상·격려**

* 포상규모('10) : 28개 (훈장2, 포장1, 국표2, 대표3, 장관상20)

2. 금년도 행사 주요 내용

□ 일정 : '10.10.29(금), 17:00~19:30 / 여의도 63시티 그랜드볼룸(2층)

□ 참석 : **장관님**, 노영민 위원, 권오현(삼성전자)·권오철(하이닉스) 사장 등 산·학·연 관계자 **총 500여명**

□ 주요내용 : **기념식**(유공자 포상 등), **리셉션** 등

구분	시간계획	내용	비고
반도체의날 기념행사	17:00~17:02(2')	○ 개회 및 국민의례	○사회자(KBS엄지인)
	17:05~17:10(5')	○ 환 영 사	○협회회장(권오현)
	17:10~17:15(5')	○ **축 사**	○**장관님**
	17:15~17:30(15')	○ **유공자 포상**	○**장관님**, 협회장
	17:30~17:40(10')	○ 반도체산업 2015비전 선포식 및 동반성장 협력 서명식	○**장관님**, 업계CEO
	17:40~17:55(15')	○ 반도체장학금 수여	○출연업체CEO
	17:55~18:00(5')	○ 성능평가팹 인증서 수여식	○상근부회장
	18:00~18:05(5')	○ 감사패 전달	○노영민의원
축하 리셉션	18:05~18:10(5')	○ 건배사	○업계원로, 지경위원
	18:10~19:30	○ 만찬	○축하공연

* **장관님**께서는 일정상 1부까지(음영부분) 참석 후 이석 예정

별첨2 정부포상 대상자 현황(훈포장, 대통령/국무총리표창)

훈격	소 속	직급	성명 (생년월일)	재직/수공 기간	공적 개요
산업 훈장 (은탑)	삼성전자	부사장	**우남성** 1953.01.07	28년 6개월	■ 선진기술과 경험을 바탕으로 시스템 반도체 분야의 핵심인 SoC 제품 기술력을 세계 일류 수준으로 향상 시키는데 주도적인 역할
산업 훈장 (석탑)	피케이엘	대표이사	**정수홍** 1955.07.18	29년 8개월	■ 일본에서 전량 수입하던 포토마스크의 핵심 원재료인 블랭크 마스크 국산화 ■ 대일 수입대체 효과에 전환점 마련
산업 포장	하이닉스 반도체	전무	**김동균** 1957.11.05	27년 2개월	■ 미국 TI사와의 기술협약에서 기술 독립을 이루어, 한국 반도체 산업의 역량을 발전
대통령 표 창	세메스	대표이사	**남상권** 1952.05.17	10년 5개월	■ 수출 1,000억원 돌파 등 무역 수지개선에 기여
	서울대학교	교수	**김재정** 1960.11.23	19년 1개월	■ 20년 동안의 장기적인 반도체 배선 연구 및 개발을 통해 반도체 산업 발전 및 활성화에 기여
국무 총리 표창	LG전자	상무	**손보익** 1961.09.15	25년 6개월	■ 세계 최초 Digital TV Chipset 개발 ■ 세계 최초 지상파 DMB 수신 SoC 개발
	앰코테크놀로지코리아	상무	**유희열** 1958.10.15	16년 7개월	■ 반도체의 전기적인 성능을 효과적으로 해결하는 기술을 개발
	전자통신 연구원	부장	**김종대** 1954.08.09	26년 2개월	■ 90nm급 디지털 및 아날로그IP 60여종을 개발

훈 격	소 속	성 명 (직위)	공 적 개 요
장 관 표 창	앰코테크놀로지코리아㈜	유 수 열 (상무)	·반도체산업 내에서 대기업-중소기업간 공동의 발전을 위해 지속적인 협력업체의 품질관리를 통해 국내 반도체 소재 협력업체의 기술력과 품질수준을 향상시켜 중소 협력업체의 글로벌 경쟁력을 증진시키는데 기여 ·통계적 공정관리를 도입, 정착함으로 회사의 품질수준을 향상시킴으로서 전세계 반도체 조립/테스트 분야에서 경쟁우위확보에 기여
	㈜실리콘화일	공 병 식 (상무)	·System-IC용 Package 관련 분야인 신제품 개발, 공정 기술개발, 원/부자재 개발 및 적용, 신기술 개발을 통해 국내 packaging 기술 향상, 원/부자재의 국산화, 관련 기업에 산업기술 전수 등을 통하여 국가 산업에 기여 했으며, 특히 최근 수년간은 CMOS image Sensor 관련 산업에 선구자 역할을 수행해 오고 있음
	엠텍비젼㈜	서 정 주 (차장)	·반도체 Fabless 기업인 엠텍비젼 인사팀에 근무하면서 반도체설계 인적자원개발을 위해 성실한 자세로 맡은 바 업무를 적극적으로 추진하였음 ·국내대학들을 방문하여 Fabless 기업에 대한 학생들의 이해를 높이고 반도체 기업간 정보교류의 역할을 하였으며, 국내 반도체설계업체의 인력·기술 확보 Needs를 위해 산학협력 코디네이팅 역할의 산학협력연계망 구축사업 참여하는 등 인적자원 개발에 기여함
	에어프로덕츠코리아㈜	김 승 회 (전무)	·수입에 의존하던 반도체 공정용 특수가스(NF3,C4F6, SiF4,TiCL4, TEOS)의 국내 개발에 성공하여 국내 반도체 업체들에 안정적인 가스 공급을 가능케 함으로서 국내 반도체 산업이 세계시장을 주도 하는데 기여함 ·수입에 의존하던 제품들의 국산화로 연간 1억불 이상의 수입대체 효과는 물론 역으로 해외 수출의 길까지 열어 (C4F6,TiCL4, SiF4등 연간 2억불 수출) 회사의 성장과 발전에 기여.

훈 격	소 속	성 명 (직위)	공 적 개 요
장 관 표 창	㈜성도이엔지	황 인 준 (이사)	·초기 삼성전자 및 하이닉스의 FAB 크린룸설비 분야에서 크린룸 UHP기술의 국산화와 중국 대만으로의 수출에도 앞장서 반도체관련 무역통상 부분에 기여한 공로가 지대함 ·아울러 대기업과의 상생협력을 통하여 공동 발전을 위해 노력하였고, 대기업-중소기업간 협의회의 회원으로서 공동의 발전을 위해 노력·기여하였음
	스테코㈜	이 재 원 (대표이사)	·08년 6월 삼성전자와 일본 Toray사가 합작하여 설립된 반도체 Backend 전문업체인 스테코의 대표이사로 취임하여 경쟁 상태인 DDI 시장에서 기술 원가 경쟁력 확보를 통해 05년 이후 감소하던 스테코 매출액 증가시킴 ·아울러 06년 세계 최초 Back End 무정지 무정체 Line을 구축하는 등 반도체 산업발전에 기여
	㈜하이닉스반도체	이 석 규 (상무)	·지식경제부 주관 차세대 비휘발성 메모리 개발 사업 및 산업 원천 기술 개발 사업 기획에 참여함으로써 개발에 대한 부담 감소, 기술 교류회를 통한 연구 방향 제시를 통한 및 연구 단계에서의 사업체 요구 사항에 반영을 통하여 개발 기간 단축 및 국내 반도체 기반 기술 확보에 공헌을 함
	㈜동진쎄미켐	김 덕 배 (상무)	·추천자가 개발한 반도체 가공용 전자 재료의 개발 성과는, 전체적으로 반도체등 첨단 IT 산업에 사용되는 재료로서, 이러한 국내 첨단산업 자체는 국제적으로 우수한 경쟁력을 보유, 세계 Top class로 자리하고 있으나, 그 근간이 되는 장비, 소재 산업은 몇몇 일부 선진국에 지배되는 불합리를 타파하는 것으로 해외 업체 주도의 소재산업을 국내 업체 주도로 변환하는 계기가 될 수 있음
	삼성전자㈜	정 규 환 (수석)	·세계 최초30nm 급 초고속DRAM 개발로 해외 경쟁사 대비 Technology 측면에서1~2 년 선행 개발을 달성하여, 기술 Leadership 을 강화하는데 기여하였음 ·DRAM 분야에서 처음으로30nm 시대를 연 혁신적인 제품으로 2010년 7월 업계 최초로 양산 개발 완료함 ·동제품은30nm 급 제품 중 최소Size 로40nm 급 제품 대비 생산성을 60% 향상시켜 매출 증대와 수출 물량 향상에 커다란 기여가 예상됨

훈 격	소 속	성 명 (직위)	공 적 개 요
장 관 표 창	㈜하이닉스 반도체	김 대 영 (수석)	·미세화 및 첨단기술(Saddle Fin,Cu DLM,eFuse)등의 접목으로 전 Tech.대비 Net Die수를 61%정도 증대시켜 생산성 향상과 제품경쟁력을 크게 증대한 고성능, 저전력 44nm급 2Gb DDR3제품개발을 리더 함 ·이번에 개발된 44nm급 2Gb DDR3에 적용된 독창적인 기술로는 Saddle Fin Cell(하이닉스 원천특허),Peri Stack Tr. 배치,Cu적용 DLM,ZAZ Capacitor,eFuse등의 첨단 기술을 적용해 기술적인 측면에서 독보적인 우위를 확보함
	삼성전자㈜	고 석 (수석)	·1981 년 삼성전자 입사 이후 반도체 조립 공정의 설비 국산화를 최초로 시작 하였으며 현재까지 설비 국산화와 자동화를 통하여 생산성 향상 과 혁 신설비 개발을 통한 회사 경영 성과에 지대한 공헌을 하였으며, 한국 반도 체 산업 발전에 선도자적인 역할을 수행하고 있음.
	주성 엔지니어링㈜	이 태 완 (수석부장)	·국내에는 전무한 epitaxial $Si_{1-x}Ge_x$, $Si_{1-x}C_x$ 증착을 위한 CVD 장치개발에 전념하였으며, 특히, 반도체 핵심장비의 국산화 및 기술독립이라는 투철한 사명감을 바탕으로 화합물반도체기술의 핵심이지만, 그동안 전량 해외 수입에 의존하고 있던 단결정 박막 성장기술인 GaN MOCVD 양산장비의 개발에 착수하여, 세계최고 생산성을 가진 양산용 장비 개발에 성공하는데 기여함
	㈜동부하이텍	김 상 권 (부장)	·2010년 0.13nm CIS의 spacer module 단순화 process를 개발하여 기존 13개공정을 5개공정으로 단축을 시켜 Photo Mask공정을 2개를 skip하는 효과를 창출 하였음 ·특히 Nor Flash에서 UV eraser공정을 skip하면서 100% 일본에서 수입을 하던 연간 1억6천만원의 UV lamp의 사용을 감소시켜 원가절감 및 폐UV lamp의 처리비용을 절감 하였습니다.
	㈜이오 테크닉스	김 남 성 (전무)	·멀티빔 반도체 레이저마킹기 개발을 통한 수출 증대 및 수입 대체 기여 ·한 대에서 최대 4개의 레이저 빔을 생성해내는 멀티빔 레이저 마킹기를 개발하여 기존 동급 속도의 마킹기보다 작업 효율을 최대 4배 이상 높임. 이러한 생산효율성 증가로주변기기를 간소화하고 공간 효율성을 높였으며, 운영 인력을 줄여 전체 운영비를 30% 이상 절감하는 효과를 가져옴

훈 격	소 속	성 명 (직위)	공 적 개 요
장 관 표 창	㈜실리콘화일	김 종 필 (수석)	·추천자가 개발한 1/4" 3M의 개발 성공으로 인해 고해상도 제품에서 상당부분 수입에 의존하던 이미지 센서의 수입 대체효과(수출 증대효과)를 가져왔으며, 메모리의 노화된 Fab을 활용하여 비메모리 제품을 양산함으로써 Fab의 활용도를 높이는데 기여함
	테크노세미켐㈜	박 휴 범 (이사)	·현재 Cu CMP Slurry, Cu Barrier metal Slurry, Cu TSV용 Slurry등 반도체 CMP 전 분야에 거쳐 다양한 연구개발을 진행하고 있으며, 소자업체와 함께 활발하게 소통하며 연구하여 기술개발에 기여함 ·아울러 Korea CMP UGM(User Group Meeting) 운영위원으로 활동 중이며, 서울대학교 반도체공동연구소 운영위원으로도 활동중
	㈜아토	이 래 일 (부장)	·기존의 RF/Plasma PE-CVD 방식에 최적화 및 안정화된 RF Matching Network, Power Control 및 Plasma Density향상 기존 대비 성능 향상된 PE-CVD 장비 개발 ·장비의 특성 및 형상은 유사 제품이 있으나, 순수 국산 기술 및 분석 기술을 통하여 외산 기술 대비 동등/우위의 장비기술력 확보하고 High Through-put, Uniformity 구현
	㈜동부하이텍	송 재 인 (상무)	·경쟁사 기술 대비, 다양하며 경쟁력있는 소자 및 PDK 확보에 성공하였으며, 이를 통하여 경쟁사의 경우 최대 16채널 LED 구동 가능한 것을 32채널 LED 구동회로를 최초로 개발하여 우리나라 파운드리 산업의 경쟁력 제고에 일조함
	㈜실리콘마이터스	김 동 희 (전무)	·추천자는 세계 최초로 DRD(Double Reduction Drive)에 적용 상용화 할수 있도록 I2C Bus및 EEPROM을 채용하여 Digital Control 할 수 있는 제품 개발 및 사업화 LCD 디스플레이용 Power Management 개발 및 국산화를 성공하는 등 우리나라 시스템반도체 발전에 기여
	㈜케이씨텍	신 인 철 (차장)	·상부 Vacuum isolation 및 소오스와 반응가스의 분리 배기에 대한 독자적인 핵심기술을 확보(핵심특허 2건 등록)하고, 시스템의 컨셉, 설계, 제작, 평가를 자체 인력을 통하여 개발(국내 특허 75건 출원(실용신안 포함), 14건 등록)하는 등 장비산업 기술 경쟁력을 제고함